

股票代码：002185

股票简称：华天科技

公告编号：2019—031



天水华天科技股份有限公司

Tianshui Huatian Technology Co., Ltd.

（甘肃省天水市秦州区双桥路 14 号）

配股说明书摘要

保荐机构（主承销商）

CREDIT SUISSE FOUNDER
瑞信方正

瑞信方正证券有限责任公司

（北京市西城区金融大街甲九号金融街中心南楼 15 层）

二〇一九年六月

声 明

本配股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读配股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。配股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺配股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证配股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。

证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

重大事项提示

本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读配股说明书中有关风险因素的章节。

一、本次配股的股份数量以实施本次配股方案的 A 股股权登记日收市后的 A 股股份总数为基数确定，按每 10 股配售 2.9327 股的比例向全体股东配售。配售股份不足 1 股的，按深交所及中登公司深圳分公司的有关规定处理。若以 2019 年 3 月 31 日公司总股本 2,131,112,944 股为基础测算，本次可配股数量总计 624,991,493 股。本次配股实施前，若因公司送股、资本公积金转增股本及其他原因导致公司总股本变动，则向全体股东配售比例不变，本次配股数量上限将按照变动后的总股本进行相应调整。

二、公司于 2018 年 10 月 19 日召开的第五届董事会第十九次会议、2018 年 11 月 6 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过了关于公司向原股东配售股份的相关议案。公司于 2019 年 1 月 14 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了关于确定本次配股比例的议案。

本次发行已经中国证监会出具《关于核准天水华天科技股份有限公司配股的批复》（证监许可[2019]966 号）核准。

公司控股股东华天电子集团已承诺以现金方式全额认购其可配售的全部股份。

三、根据《证券法》、《证券发行办法》等相关规定，本次配股采用代销方式发行。如果代销期限届满，原股东认购股票的数量未达到拟配售数量的 70%或公司控股股东不履行认配股份的承诺，则本次配股发行失败，公司将按照发行价并加算银行同期存款利息将认购款返还已经认购的股东。

四、本次配股募集资金总额不超过人民币 170,000.00 万元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金与偿还公司有息债务，其中：不超过 80,000 万元用于补充流动资金；不超过 90,000 万元用于偿还公司有息债务。

五、本次配股前公司滚存的未分配利润由配股完成后的全体股东依其持股比例享有。

六、公司利润分配政策及执行情况

（一）公司现行利润分配政策

根据公司现行有效的《公司章程》，公司的利润分配政策如下：

“第一百五十二条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10% 列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第一百五十三条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

第一百五十四条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

第一百五十五条 公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，公司利润分配不得超过累计可供分配利润

的范围，不得损害公司持续经营能力。

（一）利润分配原则

- 1、按法定顺序分配的原则。
- 2、存在未弥补亏损不得分配的原则。

（二）利润分配方式

公司利润分配可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式，并优先采用现金分红的利润分配方式。公司应积极推行以现金方式分配股利，公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。

（三）公司实施现金分红应至少同时满足下列条件

- 1、公司当年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金充裕，现金分红不会影响公司持续经营和长期发展。
- 2、审计机构对公司当年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
- 3、公司未来十二个月内无对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过最近一期经审计净资产的 30% 的事项（募集资金投资项目除外）。

（四）现金分红的比例和时间间隔

- 1、在满足现金分红条件的前提下，公司应积极采取现金分红，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。
- 2、公司原则上按年进行现金分红，也可以进行中期现金分红。
- 3、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金股利，以偿还其占用的资金。

（五）公司发放股票股利的具体条件

公司发放股票股利应至少同时满足下列条件：

- 1、公司未分配利润为正且当期可分配利润为正。
- 2、董事会认为公司具有成长性、每股净资产的摊薄、股票价格与公司股本

规模不匹配等真实合理因素，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益。

3、满足当期的现金分红条件之余，仍有利润可供分配的。

（六）利润分配的决策程序

1、公司董事会结合公司盈利情况、资金需求制订利润分配政策和预案，经董事会审议通过后提交股东大会审议批准，公司董事会在利润分配政策论证过程中，需与独立董事充分讨论。独立董事对利润分配预案独立发表意见并公开披露。

2、在符合现金分红条件的情况下，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，实施差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

董事会审议现金分红预案时，应当认真研究和论证现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其他决策程序要求事宜。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

3、股东大会审议利润分配方案时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通、交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。公司应提供多种途径（电话、传真、邮件等）接受所有股东对公司分红的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

4、公司年度盈利，但董事会未提出现金分红预案的，或因特殊情况最近三年以现金方式累计分配的利润低于最近三年实现的年均可分配利润的 30%，董事会应提交专项说明，包括未进行现金分红或现金分红比例低于 30%的原因、留存未分配利润的用途及收益情况等，由独立董事发表意见并公开披露；董事会

审议通过后提交股东大会审议并批准。

5、监事会应对董事会制订或修改的利润分配方案进行审议。若公司年度盈利但未提出现金分红方案，监事会应就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。监事会对利润分配方案的执行情况进行监督。

（七）利润分配政策调整或变更的条件和程序

如公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化，确实需要调整或变更利润分配政策的，应由董事会作出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告；有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会审核并发表意见，经公司董事会审议通过后提交股东大会并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司同时应当开通网络投票等方式为中小股东参加股东大会提供便利。

（八）利润分配方案的披露

公司应严格按照有关规定在年报中披露利润分配预案和现金分红政策制定及执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，现金分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分保护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。”

（二）最近三年公司利润分配情况

公司严格依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定落实分红政策，具体如下：

经公司 2016 年年度股东大会审议通过，公司将 2016 年度资本公积金转增股本，具体转增方案为：以公司总股本 106,555.65 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，并每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共计派发现金红利 5,327.78 万元。2017 年 6 月，上述利润分配事项实施完毕。

经公司 2017 年年度股东大会审议通过，公司以总股本 213,111.29 万股为基

数,向全体股东每10股派发现金红利0.20元(含税),共计派发现金红利4,262.23万元。2018年6月,上述利润分配事项实施完毕。

经公司2018年年度股东大会审议通过,公司以总股本213,111.29万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.20元(含税),共计派发现金红利4,262.23万元。2019年5月,上述利润分配事项实施完毕。

公司最近三年现金分红情况如下:

单位:元, %

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
2018年度	42,622,258.88	389,826,128.22	10.93
2017年度	42,622,258.88	495,169,978.15	8.61
2016年度	53,277,823.60	390,920,674.34	13.63

(三) 公司未分配利润使用情况

公司未分配利润均用于公司的生产经营发展,主要用于日常生产经营活动和资本性支出。公司注重股东回报和自身发展的平衡,在合理回报股东的情况下,公司上述未分配利润的使用,有效提升了公司未来的发展潜力和盈利能力,实现了股东利益最大化。

七、公司提醒投资者关注本次发行相关风险,具体请见本配股说明书“第三节 风险因素”的全部内容。并特别提醒投资者关注以下投资风险:

(一) 经营业绩受半导体行业景气状况影响,存在大幅波动的风险

公司所处行业受半导体行业的景气状况影响较大。半导体行业是周期性行业,受全球金融危机影响,2008年、2009年全球半导体产业出现下滑;在世界各国采取刺激经济措施以及国内扩大内需政策的影响下,国内外半导体产业在2009年第二季度逐步回暖。受全球经济前景不明等因素的影响,2011年起半导体产业销售收入增长率有所放缓。2013年至2017年,在全球经济继续缓慢复苏的影响下,全球半导体市场增速周期性回升。

为了减少半导体行业景气状况对公司业绩的影响,2008-2009年公司积极开

拓市场、加强内部管理及研发力度，营业收入仍保持了一定增长；2010 年，受半导体行业快速复苏的带动，公司营业收入大幅增长，2011 年，受国内原材料价格及人工费用上涨等影响，公司业绩出现了一定下滑。2012 年，公司通过及时调整产品结构、实施工艺升级、加强原材料管理以及实施铜线键合集成电路封装工艺升级及产业化等项目，业绩明显回升。2013 年至 2017 年，公司通过前次募集资金投资项目和研发项目的有效实施，集成电路封装能力和技术水平、成本控制能力等都得到了快速提高，经营业绩大幅增长，公司盈利能力和综合竞争能力显著提升。

受宏观经济增速放缓、半导体行业周期性波动、生产成本上升及子公司产能释放不及预期等因素影响，2018 年度公司经营业绩较上年度有所下滑。2019 年第一季度，因全球半导体行业景气度进一步下行等因素，公司经营业绩较上年同期出现大幅下滑，公司未来业绩也存在大幅下滑的风险。2019 年第一季度，A 股集成电路封测行业其他上市公司业绩也存在不同程度的大幅下滑，公司业绩变动趋势与同行业可比上市公司变动趋势相同。

总体而言，公司经营业绩仍与半导体行业的周期特征紧密相关，半导体行业发展过程中的波动将使公司面临一定的经营风险，公司业绩存在大幅波动的风险，可能对公司盈利能力产生重大不利影响。

（二）行业竞争加剧风险

近年来，我国的集成电路封装测试行业在承接全球集成电路产业向中国转移的大背景下快速发展，同时跨国企业向国内转移封装测试产业的趋势仍在延续。目前高端的封装测试产能及技术主要为中国台湾、美国等地区和国家的大型公司所掌握，这些国际企业主要通过独资或与国内企业合资的形式进行大规模投资（投资规模一般在 1 亿美元以上），不断向我国转移封装测试生产能力，加上国内集成电路封装测试企业规模不断扩大，使国内集成电路封装测试行业的竞争越来越激烈，公司盈利能力存在下滑的风险。此外，如果中国台湾地区逐步开放其半导体企业投资中国大陆的政策限制，那么全球大部分的集成电路封装测试生产能力将集中在中国，从而加大公司的经营难度和经营风险。

（三）配股发行相关风险

1、发行风险

根据《证券法》、《证券发行办法》、《证券发行与承销管理办法》等相关法律法规的规定，上市公司配股采用代销方式发行。本次配股发行对象为截至配股股权登记日收市后登记在册的发行人全体股东。如果代销期限届满，原股东认购股票的数量未达到拟配售数量的 70%或公司控股股东不履行认配股份的承诺，则本次配股发行失败，公司将按照发行价并加算银行同期存款利息将认购款返还已经认购的股东。因此，本次配股存在因原股东认配数量不足而导致发行失败的风险。

2、全部或部分放弃其所获配股认购权的现有股东于公司的权益可能将被摊薄风险

在本次配股中，若某一股东全部或部分放弃其配股认购权，即未按照其于配股方案实施股权登记日持有公司股份的比例缴款申购公司在本次配股中新增发行的普通股，该等股东于公司享有的权益可能将会相应被摊薄，即该等股东所持股份占公司总股本的百分比以及其于股东大会的表决权可能将会相应减少。根据相关规定，公司现有股东的配股认购权在本次配股中无法进行转让，因此全部或部分放弃其配股认购权的股东于公司享有的权益因其放弃配股认购权而可能被摊薄。

3、股价波动的风险

公司股票已在深交所上市。除经营和财务状况之外，公司股票价格还将受到国内宏观经济形势、股票市场投机行为、投资者心理预期和各类重大突发事件等多方面因素的影响。由于以上多种不确定性因素的存在，投资者在考虑投资公司股票时，应预计到前述各类因素可能带来的股价波动投资风险，并做出审慎判断。

目 录

声 明	2
重大事项提示	3
目 录	11
第一节 释义	13
一、普通术语	13
二、专业术语	14
第二节 本次发行概况	16
一、发行人基本情况	16
二、本次发行的基本情况	16
三、本次发行的有关机构	20
第三节 主要股东情况	23
第四节 财务会计信息	24
一、最近三年及一期财务报告审计情况	24
二、最近三年及一期财务会计资料	24
三、合并财务报表范围及变化情况	33
四、公司最近三年及一期主要财务指标及非经常性损益明细表	33
第五节 管理层讨论与分析	37
一、财务状况分析	37
二、盈利能力分析	41
三、现金流量	45

第六节 本次募集资金运用	47
一、本次募集资金的使用计划	47
二、本次募集资金运用对财务状况及经营成果的影响	51
第七节 备查文件	53

第一节 释义

在本配股说明书摘要中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：

一、普通术语

公司、本公司、发行人、华天科技	指	天水华天科技股份有限公司
本次发行、本次配股	指	公司本次向原股东配售股票并在深圳证券交易所上市的行为
控股股东、华天电子集团	指	天水华天电子集团股份有限公司（原名为“天水华天微电子股份有限公司”、“天水华天微电子有限公司”）
华天西安	指	华天科技（西安）有限公司
华天昆山	指	华天科技（昆山）电子有限公司（原名为“昆山西钛微电子科技有限公司”）
华天机械	指	天水华天机械有限公司
华天包装	指	天水华天集成电路包装材料有限公司
华天宝鸡	指	华天科技（宝鸡）有限公司
华天香港	指	华天科技（香港）产业发展有限公司（Huatian Technology (HongKong) Industrial Development Co. Limited）
华天马来西亚	指	HUATIAN TECHNOLOGY (MALAYSIA) SDN.BHD.
纪元微科	指	上海纪元微科电子有限公司
华天迈克	指	深圳市华天迈克光电子科技有限公司
华天投资	指	华天科技（西安）投资控股有限公司
西安天启	指	西安天启企业管理有限公司
中核华天	指	天水中核华天矿业有限公司
全国人大	指	中华人民共和国全国人民代表大会
国务院	指	中华人民共和国国务院
发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
科技部	指	中华人民共和国科学技术部
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
财政部	指	中华人民共和国财政部
深交所	指	深圳证券交易所
中登公司深圳分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
股东大会	指	天水华天科技股份有限公司股东大会
董事会	指	天水华天科技股份有限公司董事会
监事会	指	天水华天科技股份有限公司监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》

《证券发行办法》	指	《上市公司证券发行管理办法》
《公司章程》	指	《天水华天科技股份有限公司章程》
配股说明书	指	《天水华天科技股份有限公司配股说明书》
配股说明书摘要、本配股说明书摘要	指	《天水华天科技股份有限公司配股说明书摘要》
可转债	指	可转换公司债券
保荐机构（主承销商）	指	瑞信方正证券有限责任公司
瑞华会计师事务所、审计机构	指	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（原名国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）；发行人设立时，其名称为五联联合会计师事务所有限公司）
CCID	指	中国电子信息产业发展研究院
CSIA、半导体协会	指	中国半导体行业协会
最近三年及一期、最近三年一期、报告期内、报告期	指	2016 年度、2017 年度、2018 年度及 2019 年 1-3 月
最近三年	指	2016-2018 年
报告期各期末	指	2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日和 2019 年 3 月 31 日
元	指	人民币元
林吉特	指	马来西亚令吉

二、专业术语

半导体	指	在硅中添加三价或五价元素形成的电子器件，与导体和非导体的电路特性不同其导电具有方向性。半导体主要分为半导体集成电路、半导体分立器件两大分支
集成电路、IC	指	在一半导体基板上，利用氧化、蚀刻、扩散等方法，将众多电子电路组成各式二极管、晶体管等电子组件，做在一个微小面积上，以完成某一特定逻辑功能，达成预先设定好的电路功能要求的电路系统
分立器件	指	单一封装的半导体组件，具备电子特性功能，常见的分立式半导体器件有二极管、三极管、光电器件等
封装	指	安装半导体集成电路芯片的外壳，这个外壳不仅起着安放、固定、密封、保护芯片和增强电热性能的作用，而且是沟通内部芯片与外部电路的桥梁
测试	指	IC 封装后需要对 IC 的功能、电参数进行测量以筛选出不合格的产品，并通过测试结果来发现芯片设计、制造及封装过程中的质量缺陷
晶圆	指	多指单晶硅圆片，由普通硅沙拉制提炼而成，是最常用的半导体材料，按其直径分为4英寸、5英寸、6英寸、8英寸等规格，近来发展出12英寸甚至更大规格

引线框架类产品	指	专指以引线框架为载体的半导体封装产品
基板类产品	指	专指以 PCB、SUB 基板为载体的半导体封装产品
晶圆级产品	指	专指对整片晶圆进行封装测试后再切割成单个成品的集成电路封装产品
LED 产品	指	发光二极管产品
Bumping	指	芯片上制作凸点封装
BGA	指	Ball Grid Array 的缩写，球栅阵列封装
CSP	指	Chip Size Package的缩写，芯片级封装
DIP	指	Dual In-line Package的缩写，双列直插式封装
DFN	指	Dual Flat No-lead的缩写，双边扁平无引脚封装
eTSSOP	指	Explode Thin Shrink Small Outline Package的缩写，外露载体薄的紧缩型小外形表面封装
FlipChip、FC	指	倒装封装或覆晶封装
LQFP	指	Low profile Quad Flat Package的缩写，薄型四边引线扁平封装
LGA	指	Land Grid Array的缩写，触点阵列封装
LED	指	Light-Emitting Diode的缩写，发光二极管
MCP	指	Multi-chip Package的缩写，多芯片封装
MCM	指	Multi Chip Module的缩写，多芯片组件封装
MEMS	指	Micro-Electro-Mechanical Systems的缩写，微机电系统
QFN	指	Quad Flat Non-leaded Package的缩写，方型扁平无引脚封装
QFP	指	Quad Flat Package的缩写，四边引线扁平封装
SIP	指	Single in Package的缩写，单列直插式封装
SDIP	指	Shrink Dual In-line Package的缩写，小间距双列直插式封装
SiP	指	System in Package的缩写，系统级封装
SOT	指	Small Out-line Transistor的缩写，小外形晶体管封装
SOP	指	Small Out-line Package的缩写，小外形表面封装
SSOP	指	Shrink Small Out-line Package的缩写，紧缩型小外型表面封装
TSSOP	指	Thin Shrink Small Out-line Package的缩写，薄的紧缩型小外形表面封装
TQFP	指	Thin Quad Flat Package的缩写，薄塑料四角扁平封装
TSV	指	Through-Silicon Via的缩写，直通硅晶穿孔封装，即硅通孔封装
WLP	指	Wafer Level Packaging的缩写，晶圆级封装

本配股说明书摘要除特别说明外，所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第二节 本次发行概况

一、发行人基本情况

上市公司名称	天水华天科技股份有限公司
英文名称	Tianshui Huatian Technology Co.,Ltd.
法定代表人	肖胜利
统一社会信用代码	91620500756558610D
成立日期	2003 年 12 月 25 日
营业期限	2003 年 12 月 25 日至 2053 年 12 月 24 日
注册资本	2,131,112,944 元
注册地址	甘肃省天水市秦州区双桥路 14 号
邮政编码	741001
电话	0938-8631816/8631990
传真	0938-8632260
互联网网址	http://www.tshtkj.com
电子信箱	Wenying.Chang@ht-tech.com
所属行业	计算机、通信和其他电子设备制造业
经营范围	半导体集成电路研发、生产、封装、测试、销售；LED 及应用产品和 MEMS 研发、生产、销售；电子产业项目投资；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务；房屋租赁；水、电、气及供热、供冷等相关动力产品和服务（国家限制的除外）。
A 股上市信息	上市地：深交所 证券代码：002185 证券简称：华天科技

二、本次发行的基本情况

（一）本次发行的核准情况

公司于 2018 年 10 月 19 日召开的第五届董事会第十九次会议、2018 年 11 月 6 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过了关于公司向原股东配售股份的相关议案。公司于 2019 年 1 月 14 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了关于确定本次配股比例的议案。

本次发行已经中国证监会出具《关于核准天水华天科技股份有限公司配股的批复》（证监许可[2019]966 号）核准。

（二）发行股票的种类和面值

本次拟发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

（三）发行方式

本次发行采用向原股东配售股份（配股）方式进行。

（四）配股基数、比例和数量

本次配股的股份数量以实施本次配股方案的 A 股股权登记日收市后的 A 股股份总数为基数确定，按每 10 股配售 2.9327 股的比例向全体股东配售。配售股份不足 1 股的，按深交所及中登公司深圳分公司的有关规定处理。若以 2019 年 3 月 31 日公司总股本 2,131,112,944 股为基础测算，本次可配股数量总计 624,991,493 股。本次配股实施前，若因公司送股、资本公积金转增股本及其他原因导致公司总股本变动，则向全体股东配售比例不变，本次配股数量上限将按照变动后的总股本进行相应调整。

公司控股股东华天电子集团已承诺以现金方式全额认购其可配售的股份。

（五）配股定价依据及配股价格

1、定价原则

（1）本次配股价格不低于发行前公司最近一期经审计的每股净资产值；若在配股发行股权登记日前，公司总股本由于派送红股或资本公积金转增股本或其他原因而发生变动，则配股价格下限为公司总股本变动后的每股净资产值；

（2）参考发行时公司股票在二级市场的价格、市盈率及市净率等估值指标，并综合考虑公司的发展前景与股东利益、本次募集资金投资项目计划的资金需求量、公司的实际情况等因素；

（3）遵循公司董事会及其授权人士与保荐机构（主承销商）协商确定原则。

2、配股价格

本次配股价格以刊登发行公告前 20 个交易日公司股票交易均价为基数，采用市价折扣法确定配股价格。最终配股价格根据股东大会授权，由公司董事会及其授权人士在发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

2019 年 6 月 26 日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于确定公司配股价格的议案》，根据公司本次配股方案的定价依据，结合市场情况，经与保荐机构（主承销商）协商，确定公司配股价格为 2.72 元/股。

（六）配售对象

配售对象为本次配股股权登记日当日收市后在中登公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，本次配股股权登记日为 2019 年 7 月 2 日。

公司控股股东华天电子集团已承诺以现金方式全额认购其可配售的全部股份。

（七）本次配股募集资金投向

本次配股预计募集资金总额不超过人民币 170,000.00 万元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金与偿还公司有息债务，其中：不超过 80,000 万元用于补充流动资金；不超过 90,000 万元用于偿还公司有息债务。

若本次募集资金净额低于上述项目拟投入募集金额，不足部分由公司自筹解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会及其授权人士可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次募集资金到位前，公司将根据有息债务的实际到期日通过自筹资金先行偿还，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。

（八）本次配股前滚存利润分配方案

本次配股实施前公司滚存的未分配利润，由本次配股完成后的全体股东依其持股比例享有。

（九）承销方式

本次配股由保荐机构（主承销商）以代销方式承销。

（十）发行费用

项目	金额
保荐费用和承销费用	【】
审计验资费用	【】
律师费用	【】
登记及其他费用	【】
合计	【】

（十一）本次配股发行日程安排

本次发行期间的主要日程与停牌安排如下：

交易日	日期	配股安排	停牌安排
R-2 日	2019 年 6 月 28 日	刊登配股说明书及摘要、配股发行公告、网上路演公告	正常交易
R-1 日	2019 年 7 月 1 日	网上路演	正常交易
R 日	2019 年 7 月 2 日	股权登记日	正常交易
R+1 日至 R+5 日	2019 年 7 月 3 日至 2019 年 7 月 9 日	配股缴款起止日期； 配股提示性公告（5 次）	全天停牌
R+6 日	2019 年 7 月 10 日	登记公司网上清算	全天停牌
R+7 日	2019 年 7 月 11 日	发行结果公告； 发行成功的除权基准日或发行失败的恢复交易日及发行失败的退款日	复牌，正常交易

注：以上日期为深圳证券交易所交易日。2019 年 6 月 28 日（R-2 日），深港通北向休市。2019 年 7 月 1 日（R-1 日）为香港公众假期，深港通北向休市。如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）和公司将及时公告，修改本次发行日程。

（十二）本次发行股份的上市流通

本次配股完成后，公司将申请本次发行的股票在深交所上市流通。

三、本次发行的有关机构

（一）发行人：天水华天科技股份有限公司

住所：甘肃省天水市秦州区双桥路 14 号

法定代表人：肖胜利

联系人：常文璞

联系地址：甘肃省天水市秦州区赤峪路 88 号

联系电话：0938-8631816/8631990

传真：0938-8632260

（二）保荐机构（主承销商）：瑞信方正证券有限责任公司

住所：北京市昌平区回龙观镇金燕龙大厦 19 层 1903、1905 号

法定代表人：高利

保荐代表人：陈万里、盖建飞

项目协办人：任岚

项目组其他人员：孙志洁、贾培、关晓凡、李晶、杨茜

联系地址：北京市西城区金融大街甲九号金融街中心南楼 15 层

联系电话：010-66538666

传真：010-66538566

（三）发行人律师：北京市竞天公诚律师事务所

住所：北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层

负责人：赵洋

经办律师：胡铮铮、何亦龙

联系地址：北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层

联系电话：010-58091000

传真：010-58091100

（四）会计师事务所：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层

执行事务合伙人：刘贵彬

经办注册会计师：张海英、魏兴花、刘志文、宫岩

联系地址：甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 A 座 12-13 层

联系电话：0931-8441572

传真：0931-8441705

（五）申请上市的证券交易所：深圳证券交易所

地址：深圳市福田区深南大道 2012 号

电话：0755-88668888

传真：0755-82083947

（六）保荐人收款银行：中国民生银行北京木樨地支行

户名：瑞信方正证券有限责任公司

收款账号：610005692

联系人：许志新、李笑成

联系地址：北京市海淀区复兴路甲 3 号

联系电话：010-88654200

传真：010-88654103

(七) 募集资金专项账户银行：招商银行兰州高新技术开发区支行

户名：天水华天科技股份有限公司

收款账号：931903397610777

联系人：李重达

联系地址：甘肃省兰州市城关区雁南路 551 号

联系电话：0931-2140320

传真：0931-2140325

第三节 主要股东情况

截至 2019 年 3 月 31 日，发行人前 10 大股东名称及持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)	股份 性质
1	天水华天电子集团股份有限公司	553,369,460	25.97	流通股
2	招商财富—招商银行—汇垠天粤1号专项资产管理计划	29,819,550	1.40	流通股
3	香港中央结算有限公司	25,368,690	1.19	流通股
4	中央汇金资产管理有限责任公司	16,314,740	0.77	流通股
5	挪威中央银行—自有资金	12,508,093	0.59	流通股
6	加拿大年金计划投资委员会—自有资金	12,165,265	0.57	流通股
7	全国社保基金一一零组合	10,586,686	0.50	流通股
8	平安信托有限责任公司—投资精英之淡水泉	8,272,100	0.39	流通股
9	杭州友旺电子有限公司	8,052,430	0.38	流通股
10	魁北克储蓄投资集团	7,311,938	0.34	流通股
合计		683,768,952	32.10	

截至本配股说明书摘要出具日，华天电子集团共持有发行人股份 5.53 亿股，占公司股份总数的 25.97%。

第四节 财务会计信息

一、最近三年及一期财务报告审计情况

公司聘请瑞华会计师事务所对 2016 年度、2017 年度和 2018 年度财务报表进行了审计，并分别出具了瑞华审字瑞华审字[2017]62020004 号、瑞华审字[2018]62070002 号和瑞华审字[2019]62070021 号标准无保留意见的审计报告。

未经特别说明，公司 2016 年至 2019 年一季度财务报告的财务资料摘自瑞华审字[2017]62020004 号、瑞华审字[2018]62070002 号和瑞华审字[2019]62070021 号标准无保留意见的审计报告和公司未经审计的 2019 年一季度财务报告。公司在编制如下最近三年一期财务报表时执行了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）相关政策，对报表列式进行了追溯调整。

二、最近三年及一期财务会计资料

（一）合并财务报表

1、合并资产负债表

单位：万元

项目	2019.3.31	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
流动资产：				
货币资金	140,622.04	309,699.98	93,208.42	119,515.47
应收票据及应收账款	133,086.04	112,297.21	101,680.18	87,886.82
其中：应收票据	14,130.69	10,549.03	14,158.12	11,643.41
应收账款	118,955.36	101,748.18	87,522.06	76,243.41
预付款项	4,318.46	3,299.31	3,331.42	3,682.66
其他应收款	4,726.54	3,890.47	8,106.81	2,956.49
存货	140,744.65	113,457.74	142,752.96	85,470.17
其他流动资产	16,001.92	15,261.49	9,235.02	17,434.09
流动资产合计	439,499.66	557,906.20	358,314.81	316,945.70
非流动资产：				
可供出售金融资产	-	8,653.92	8,629.27	6,446.93
长期股权投资	3,637.37	3,642.55	181.71	75.29

项目	2019.3.31	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
其他非流动金融资产	22,587.14	-	-	-
投资性房地产	783.68	821.59	884.89	355.18
固定资产	759,086.90	567,949.05	450,795.23	327,331.81
在建工程	49,090.39	40,068.60	49,699.04	57,328.86
无形资产	37,055.55	17,741.12	16,338.43	17,921.17
商誉	78,466.14	1,856.76	1,856.76	2,293.68
长期待摊费用	462.20	477.08	136.39	167.73
递延所得税资产	6,246.58	5,906.68	4,369.07	4,069.49
其他非流动资产	42,953.79	39,244.68	45,438.81	34,788.57
非流动资产合计	1,000,369.76	686,362.04	578,329.61	450,778.71
资产总计	1,439,869.42	1,244,268.24	936,644.42	767,724.41
流动负债：				
短期借款	225,198.54	210,088.54	53,213.68	1,500.00
应付票据及应付账款	162,724.94	154,400.04	168,247.55	115,098.10
预收款项	3,487.82	4,353.08	2,376.36	1,784.04
应付职工薪酬	4,644.61	10,765.59	13,046.04	9,708.27
应交税费	1,822.46	745.58	4,033.84	1,949.12
其他应付款	25,263.62	22,403.98	19,529.38	19,522.16
一年内到期的非流动负债	33,761.27	39,256.36	10,122.00	33,315.19
流动负债合计	456,903.27	442,013.17	270,568.85	182,876.89
非流动负债：				
长期借款	178,112.37	137,378.00	40,877.47	7,625.47
长期应付款	6,032.95	6,025.42	5,756.00	6,578.00
长期应付职工薪酬	6,010.75	-	-	-
预计负债	-	-	87.81	-
递延所得税负债	10,099.34	600.11	951.93	1,781.26
递延收益	21,778.38	20,758.68	18,848.30	18,323.08
非流动负债合计	222,033.78	164,762.21	66,521.51	34,307.81
负债合计	678,937.05	606,775.38	337,090.36	217,184.70
所有者权益：				
股本	213,111.29	213,111.29	213,111.29	106,555.65
资本公积	113,056.44	113,056.44	112,806.75	219,362.40
其他综合收益	-2,238.46	28.92	504.92	941.54
专项储备	507.47	400.86	135.25	-
盈余公积	24,061.85	22,532.22	19,013.54	15,699.90
未分配利润	236,455.88	220,325.99	189,124.28	148,248.70
归属于母公司所有者权益合计	584,954.48	569,455.73	534,696.03	490,808.19
少数股东权益	175,977.89	68,037.14	64,858.03	59,731.52

项目	2019.3.31	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
所有者权益合计	760,932.37	637,492.86	599,554.06	550,539.71
负债和所有者权益总计	1,439,869.42	1,244,268.24	936,644.42	767,724.41

2、合并利润表

单位：万元

项目	2019 年 1-3 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
营业总收入	171,132.70	712,170.63	700,987.61	547,502.78
营业收入	171,132.70	712,170.63	700,987.61	547,502.78
营业总成本	171,439.02	674,288.49	647,514.73	507,693.80
营业成本	151,244.31	595,931.04	575,535.99	448,717.47
税金及附加	540.15	2,826.87	3,094.42	1,953.31
销售费用	1,920.97	7,989.76	7,389.15	6,142.82
管理费用	7,240.62	26,243.21	23,070.08	21,191.46
研发费用	6,323.48	38,351.20	35,333.76	28,993.18
财务费用	4,161.74	1,410.94	627.53	-1,172.65
其中：利息费用	3,707.63	7,709.31	1,913.21	1,949.75
利息收入	288.87	1,666.76	1,385.82	2,424.56
资产减值损失	7.74	1,535.47	2,463.79	1,868.20
加：其他收益	1,777.88	10,403.35	8,176.01	-
投资收益	60.26	16.44	360.86	1,792.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5.18	-3.46	-40.57	-17.10
公允价值变动收益	31.64	-	-	-
资产处置收益	2.26	594.52	931.53	-207.42
营业利润	1,565.72	48,896.44	62,941.29	41,393.95
加：营业外收入	165.98	756.45	378.47	7,531.76
减：营业外支出	23.84	1,622.15	205.32	1,091.15
利润总额	1,707.85	48,030.74	63,114.44	47,834.56
减：所得税	-111.43	5,107.03	8,412.61	6,506.48
净利润	1,819.29	42,923.71	54,701.83	41,328.08
归属于母公司所有者的净利润	1,665.79	38,982.61	49,517.00	39,092.07
少数股东损益	153.50	3,941.10	5,184.84	2,236.01
其他综合收益	-2,495.75	-476.00	-436.63	497.48
综合收益总额	-676.47	42,447.72	54,265.21	41,825.56
归属于母公司普通股股东综合收益总额	-601.59	38,506.62	49,080.37	39,589.55
归属于少数股东的综合收益总额	-74.87	3,941.10	5,184.84	2,236.01
每股收益：				
基本每股收益	0.0078	0.1829	0.2324	0.1834

项目	2019 年 1-3 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
稀释每股收益	0.0078	0.1829	0.2324	0.1834

3、合并现金流量表

单位：万元

项目	2019 年 1-3 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	114,755.58	384,227.86	331,337.39	257,411.39
收到的税费返还	2,234.72	18,270.99	14,901.21	9,488.23
收到其他与经营活动有关的现金	2,384.80	24,469.00	15,942.21	23,008.27
经营活动现金流入小计	119,375.10	426,967.85	362,180.82	289,907.89
购买商品、接受劳务支付的现金	63,103.44	183,552.13	160,258.47	110,220.49
支付给职工以及为职工支付的现金	40,207.62	98,750.98	82,074.60	68,630.18
支付的各项税费	1,313.55	16,117.59	12,884.13	11,152.44
支付其他与经营活动有关的现金	3,352.00	15,244.02	16,610.03	13,652.65
经营活动现金流出小计	107,976.62	313,664.72	271,827.23	203,655.76
经营活动产生的现金流量净额	11,398.48	113,303.13	90,353.59	86,252.13
投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	-	-	2,600.00	-
取得投资收益收到的现金	1,490.95	19.90	376.71	172.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.19	432.45	980.95	883.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	375.66	-
收到其他与投资活动有关的现金	2,039.07	249,077.21	78,945.84	184,846.61
投资活动现金流入小计	3,530.22	249,529.57	83,279.16	185,902.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,888.10	163,594.96	180,007.60	148,459.15
投资支付的现金	-	3,464.30	3,189.76	2,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	185,565.39	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	3,102.06	227,423.01	69,467.50	178,832.30
投资活动现金流出小计	216,555.55	394,482.27	252,664.87	329,891.44
投资活动产生的现金流量净额	-213,025.34	-144,952.70	-169,385.71	-143,989.35
筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	-	300.00	100.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	300.00	100.00
取得借款收到的现金	89,907.64	369,756.70	109,266.17	19,007.41

项目	2019 年 1-3 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
收到其他与筹资活动有关的现金	89,907.64	-	2,036.97	-
筹资活动现金流入小计	51,081.93	369,756.70	111,603.15	19,107.41
偿还债务支付的现金	4,150.99	88,260.49	48,081.47	38,546.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	11,811.92	7,290.53	6,801.81
支付其他与筹资活动有关的现金	194.34	932.30	39.34	15,715.93
筹资活动现金流出小计	55,427.26	101,004.71	55,411.34	61,064.23
筹资活动产生的现金流量净额	34,480.39	268,752.00	56,191.81	-41,956.82
汇率变动对现金的影响	-2,950.97	-618.91	-540.58	195.92
现金及现金等价物净增加额	-170,097.44	236,483.51	-23,380.89	-99,498.12
期初现金及现金等价物余额	305,834.72	69,351.21	92,732.10	192,230.21
期末现金及现金等价物余额	135,737.28	305,834.72	69,351.21	92,732.10

(二) 母公司财务报表

1、母公司资产负债表

单位：万元

项目	2019.3.31	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
流动资产：				
货币资金	30,402.35	45,494.16	44,749.48	54,497.83
应收票据及应收账款	57,409.10	57,788.19	54,216.42	45,552.83
其中：应收票据	8,381.82	5,440.22	8,932.72	7,623.06
应收账款	49,027.28	52,347.98	45,283.70	37,929.76
预付款项	891.00	551.33	432.27	2,653.64
其他应收款	1,030.71	1,042.52	1,271.94	1,284.82
存货	47,986.67	48,488.40	48,816.78	36,628.27
其他流动资产	7,726.57	8,786.71	5,345.34	2,824.26
流动资产合计	145,446.41	162,151.31	154,832.22	143,441.64
非流动资产：				
可供出售金融资产	-	6,369.99	6,369.99	3,327.23
长期股权投资	513,123.93	484,668.53	261,749.57	260,259.68
其他非流动金融资产	21,453.95	-	-	-
投资性房地产	263.99	274.12	314.65	355.18
固定资产	246,564.73	246,328.57	188,633.46	143,231.59
在建工程	5,119.71	4,128.52	10,469.59	8,349.71
无形资产	5,303.20	5,303.64	5,354.80	5,518.70
递延所得税资产	2,057.83	2,138.87	2,132.37	2,153.42
其他非流动资产	1,844.10	1,766.21	8,373.52	9,328.63
非流动资产合计	795,731.43	750,978.45	483,397.94	432,524.14
资产总计	941,177.84	913,129.76	638,230.16	575,965.78
流动负债：				
短期借款	174,500.00	154,500.00	31,000.00	-
应付票据及应付账款	72,183.17	77,588.62	57,194.66	47,559.72
预收款项	773.05	1,034.38	427.26	828.40
应付职工薪酬	-	5,070.89	5,166.70	4,074.28
应交税费	759.60	103.68	1,391.96	1,019.90
其他应付款	17,399.65	18,056.39	17,149.42	10,111.86
一年内到期的非流动负债	3,922.00	13,822.00	822.00	26,822.00
流动负债合计	269,537.47	270,175.96	113,152.00	90,416.16
非流动负债：				
长期借款	110,900.00	101,000.00	13,000.00	-
长期应付款	4,934.00	4,934.00	5,756.00	6,578.00

项目	2019.3.31	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
递延收益	9,482.96	10,023.21	10,515.74	11,109.04
非流动负债合计	125,316.96	115,957.21	29,271.74	17,687.04
负债合计	394,854.43	386,133.16	142,423.74	108,103.20
所有者权益：				
股本	213,111.29	213,111.29	213,111.29	106,555.65
资本公积	123,900.13	123,900.13	123,900.13	230,455.78
专项储备	507.47	400.86	135.25	-
盈余公积	24,175.50	22,532.22	19,013.54	15,699.90
未分配利润	184,629.01	167,052.09	139,646.20	115,151.25
所有者权益合计	546,323.41	526,996.59	495,806.41	467,862.58
负债和所有者权益总计	941,177.84	913,129.76	638,230.16	575,965.78

2、母公司利润表

单位：万元

项目	2019 年 1-3 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
营业总收入	73,280.85	355,797.64	333,933.81	259,642.31
营业收入	73,280.85	355,797.64	333,933.81	259,642.31
营业总成本	70,787.36	322,360.06	298,620.16	229,236.21
营业成本	61,571.88	288,747.59	270,087.82	204,506.23
税金及附加	64.23	1,345.47	1,824.29	1,208.93
销售费用	702.39	4,035.05	3,449.29	3,298.89
管理费用	3,281.76	10,988.06	9,029.66	7,867.56
研发费用	2,843.62	15,086.33	13,436.68	12,479.11
财务费用	2,323.48	1,603.87	339.49	-750.95
其中：利息费用	2,530.28	3,526.78	1,039.83	923.99
利息收入	82.54	953.05	830.90	1,050.43
资产减值损失	-	553.69	452.94	626.43
加：其他收益	614.12	3,187.18	2,797.13	-
投资收益	54.82	4,166.48	-36.97	410.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5.18	-21.22	-36.97	-17.10
资产处置收益	-0.35	-1.64	185.83	-74.69
营业利润	3,162.08	40,789.60	38,259.64	30,741.42
加：营业外收入	117.16	227.92	238.12	3,623.07
减：营业外支出	-	1,355.57	28.63	0.58
利润总额	3,279.24	39,661.95	38,469.13	34,363.92
减：所得税	491.89	4,475.15	5,332.76	4,677.50
净利润	2,787.35	35,186.79	33,136.37	29,686.42

3、母公司现金流量表

单位：万元

项目	2019 年 1-3 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	38,390.09	169,788.39	135,091.12	114,597.04
收到的税费返还	997.65	1,565.22	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	602.58	7,811.06	9,744.53	9,066.77
经营活动现金流入小计	39,990.31	179,164.67	144,835.65	123,663.80
购买商品、接受劳务支付的现金	17,005.81	58,645.37	51,476.16	37,450.05
支付给职工以及为职工支付的现金	14,199.82	41,939.06	34,052.12	28,155.69
支付的各项税费	213.03	7,121.21	7,613.39	6,906.46
支付其他与经营活动有关的现金	3,117.38	5,533.33	5,480.01	4,760.65
经营活动现金流出小计	34,536.03	113,238.97	98,621.68	77,272.85
经营活动产生的现金流量净额	5,454.28	65,925.70	46,213.97	46,390.96
投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	3,000.00	-	-	-
取得投资收益收到的现金	1,408.90	2,721.60	-	172.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.19	11.21	720.27	11.09
收到其他与投资活动有关的现金	-	207,516.61	62,565.06	93,539.73
投资活动现金流入小计	4,409.09	210,249.41	63,285.33	93,722.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,643.55	61,999.15	63,327.54	48,946.57
投资支付的现金	31,460.58	222,996.60	4,569.62	9,425.46
支付其他与投资活动有关的现金	2,693.40	186,914.01	61,733.68	81,167.76
投资活动现金流出小计	44,797.53	471,909.76	129,630.84	139,539.79
投资活动产生的现金流量净额	-40,388.44	-261,660.35	-66,345.51	-45,816.97
筹资活动产生的现金流量：				
取得借款收到的现金	45,000.00	261,500.00	44,000.00	7,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	1,131.40	-
筹资活动现金流入小计	45,000.00	261,500.00	45,131.40	7,400.00
偿还债务支付的现金	25,000.00	37,822.00	26,822.00	5,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,771.35	7,495.91	6,476.10	5,738.37
筹资活动现金流出小计	27,771.35	45,317.91	33,298.10	10,738.37
筹资活动产生的现金流量净额	17,228.65	216,182.09	11,833.30	-3,338.37
汇率变动对现金的影响	-79.70	-400.15	-178.71	142.68
现金及现金等价物净增加额	-17,785.21	20,047.28	-8,476.95	-2,621.70
期初现金及现金等价物余额	44,194.04	24,146.76	32,623.71	35,245.41

项目	2019 年 1-3 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
期末现金及现金等价物余额	26,408.83	44,194.04	24,146.76	32,623.71

三、合并财务报表范围及变化情况

（一）合并财务报表范围

截至 2019 年 3 月 31 日，公司财务报表合并范围内的一级子公司情况如下：

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
华天包装	甘肃省天水市	甘肃省天水市	集成电路行业	100.00	-	购买取得
华天机械	甘肃省天水市	甘肃省天水市	机械制造行业	89.10	-	购买取得
华天西安	陕西省西安市	陕西省西安市	集成电路行业	72.77	-	购买取得
华天昆山	江苏省昆山开发区	江苏省昆山开发区	集成电路行业	93.04	5.70	购买取得
中核华天	甘肃省天水市	甘肃省天水市	采掘业	70.00	-	投资设立
华天香港	香港特别行政区	香港特别行政区	投资、进出口贸易	100.00	-	投资设立
华天迈克	广东省深圳市	广东省深圳市	LED 行业	56.46	-	购买取得
纪元微科	上海市	上海市	集成电路行业	100.00	-	购买取得
西安天启	陕西省西安市	陕西省西安市	投资	100.00	-	投资设立
华天投资	陕西省西安市	陕西省西安市	集成电路行业	70.00	21.83	投资设立

（二）合并财务报表范围（一级子公司）变化情况

2016 年度，公司在西安设立全资子公司西安天启，西安天启自成立之日起纳入公司合并报表范围。

2017 年度，公司未新增或注销一级子公司。

2018 年度，公司新设立全资子公司华天宝鸡以及控股子公司华天投资，上述公司自成立之日起纳入合并报表范围。

2019 年一季度，公司未新增或注销一级子公司，公司将持有的华天宝鸡股权转让给华天投资。

四、公司最近三年及一期主要财务指标及非经常性损益明细表

（一）公司报告期内主要财务指标

财务指标	2019.3.31	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
流动比率	0.96	1.26	1.32	1.73
速动比率	0.65	1.01	0.80	1.27
资产负债率（%）（母公司）	41.95	42.29	22.32	18.77
资产负债率（%）（合并）	47.15	48.77	35.99	28.29

财务指标	2019年1-3月	2018年度	2017年度	2016年度
利息保障倍数（倍）	1.46	7.23	33.99	25.53
经营活动现金流量净额（万元）	11,398.48	113,303.13	90,353.59	86,252.13
每股经营活动现金流量净额（元/股）	0.05	0.53	0.42	0.81
每股净现金流量（元/股）	-0.80	1.11	-0.11	-0.93
研发费用占营业收入的比例（%）	3.70	5.39	5.04	5.30
资产周转率（次）	0.13	0.65	0.82	0.74
流动资产周转率（次）	0.34	1.55	2.08	1.58
存货周转率（次）	1.19	4.65	5.04	6.49
应收账款周转率（次）	1.55	7.53	8.56	7.97

注 1：除资产负债率（母公司）外，上述财务指标均以合并报表口径进行计算；

注 2：2019 年 1-3 月，上述指标进行计算时未进行年化处理；

注 3：上述财务指标的计算公式：

流动比率=流动资产÷流动负债

速动比率=（流动资产-存货）÷流动负债

资产负债率=（负债总额÷资产总额）×100%

利息保障倍数=（利润总额+利息支出）÷利息支出

每股经营活动现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额 / 期末股本总额

每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额 / 期末股本总额

资产周转率=营业收入÷[（期初资产总额+期末资产总额）÷2]

流动资产周转率=营业收入÷[（期初流动资产+期末流动资产）÷2]

存货周转率=营业成本÷[（期初存货账面价值+期末存货账面价值）÷2]

应收账款周转率=营业收入÷[（期初应收账款账面价值+期末应收账款账面价值）÷2]

（二）公司报告期内净资产收益率及每股收益

项目	2019年1-3月	2018年度	2017年度	2016年度
基本每股收益（元/股）	0.0078	0.1829	0.2324	0.1834
基本每股收益（扣非后，元/股）	0.0004	0.1444	0.1987	0.1600
稀释每股收益（元/股）	0.0078	0.1829	0.2324	0.1834
稀释每股收益（扣非后，元/股）	0.0004	0.1444	0.1987	0.1600
加权平均净资产收益率（%）	0.28	7.07	9.67	8.19
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.01	5.58	8.26	7.14
营业毛利率（%）	11.62	16.32	17.90	18.04

注 1：基本每股收益=P÷S，S=S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk

注 2：稀释每股收益=（P+（已确认为费用的稀释性潜在普通股利息-转换费用）×（1-所得税率）/（S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数）

注 3：净资产收益率（加权平均）=P/（E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）*100%

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；NP 为归属于本公司普通股股东的净利润；E0 为归属于本公司普通股股东的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于本公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属

于本公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数，Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数

注 4：营业毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入*100%

（三）最近三年及一期非经常性损益明细表

报告期内，公司的非经常性损益明细如下：

单位：万元

非经常性损益项目	2019 年 1-3 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	2.26	587.62	868.34	-207.42
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,889.55	10,671.67	8,151.00	7,218.17
委托他人投资或管理资产的损益	5.50	19.90	59.76	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	31.59	-	300.00	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	41.96	8.10	30.85
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	142.25	-835.62	260.25	-777.56
减：所得税影响数	316.03	1,440.54	1,402.12	928.77
少数股东权益影响额（税后）	172.34	831.13	1,069.98	347.30
合计	1,582.78	8,213.85	7,175.36	4,987.97

经计算，公司扣除非经常性损益后的净利润金额如下：

单位：万元，%

非经常性损益项目	2019 年 1-3 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
归属于普通股股东的净利润	1,665.79	38,982.61	49,517.00	39,092.07
减：扣除所得税后归属于普通股股东的非经常性损益	1,582.78	8,213.85	7,175.36	4,987.97
扣除非经常性损益后的净利润	83.01	30,768.76	42,341.64	34,104.10
扣除所得税后归属于普通股股东的非经常性损益占归属普通	95.02	21.07	14.49	12.76

非经常性损益项目	2019 年 1-3 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
股股东的净利润比重				

公司非经常性损益项目主要为政府补助，公司所处的集成电路行业是国家大力支持发展的行业。2014 年，国务院颁布了《国家集成电路产业发展推进纲要》，提出了大力发展集成电路产业的目标；2016 年，全国人大第十二届四次会议颁布了《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，提出要大力推进先进半导体等新兴前沿领域创新和产业化，形成一批新增长点；2017 年，发改委颁布《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 版）》，将集成电路芯片设计及服务列入战略性新兴产业重点产品目录。国家对集成电路行业发展的支持，使得公司政府补助金额在报告期内维持较高水平。

报告期内，公司扣除所得税后归属于普通股股东的非经常性损益占归属于普通股股东的净利润比例分别为 12.76%、14.49%、21.07%和 95.02%，2018 年和 2019 年一季度占比提高较多，主要原因是受半导体行业周期性波动和生产成本上升、子公司产能释放不及预期等因素影响，公司经营业绩有所下滑。

第五节 管理层讨论与分析

本节引用的财务数据分别引自瑞华审字[2017]62020004 号、瑞华审字[2018]62070002 号和瑞华审字[2019]62070021 号标准无保留意见的审计报告和公司未经审计的 2019 年一季度财务报告。公司在编制如下最近三年一期财务报表时执行了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）相关政策，对报表列式进行了追溯调整。非经特别说明，均为合并报表口径。

一、财务状况分析

（一）资产状况分析

报告期各期末，公司资产规模及资产结构情况如下：

单位：万元，%

项目	2019.3.31		2018.12.31		2017.12.31		2016.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产：								
货币资金	140,622.04	9.77	309,699.98	24.89	93,208.42	9.95	119,515.47	15.57
应收票据及应收账款	133,086.04	9.24	112,297.21	9.03	101,680.18	10.86	87,886.82	11.45
其中：应收票据	14,130.69	0.98	10,549.03	0.85	14,158.12	1.51	11,643.41	1.52
应收账款	118,955.36	8.26	101,748.18	8.18	87,522.06	9.34	76,243.41	9.93
预付款项	4,318.46	0.30	3,299.31	0.27	3,331.42	0.36	3,682.66	0.48
其他应收款	4,726.54	0.33	3,890.47	0.31	8,106.81	0.87	2,956.49	0.39
存货	140,744.65	9.77	113,457.74	9.12	142,752.96	15.24	85,470.17	11.13
其他流动资产	16,001.92	1.11	15,261.49	1.23	9,235.02	0.99	17,434.09	2.27
流动资产合计	439,499.66	30.52	557,906.20	44.84	358,314.81	38.26	316,945.70	41.28
非流动资产：								
可供出售金融资产	-	-	8,653.92	0.70	8,629.27	0.92	6,446.93	0.84
长期股权投资	3,637.37	0.25	3,642.55	0.29	181.71	0.02	75.29	0.01
其他非流动金融资产	22,587.14	1.57	-	-	-	-	-	-
投资性房地产	783.68	0.05	821.59	0.07	884.89	0.09	355.18	0.05
固定资产	759,086.90	52.72	567,949.05	45.65	450,795.23	48.13	327,331.81	42.64
在建工程	49,090.39	3.41	40,068.60	3.22	49,699.04	5.31	57,328.86	7.47
无形资产	37,055.55	2.57	17,741.12	1.43	16,338.43	1.74	17,921.17	2.33
商誉	78,466.14	5.45	1,856.76	0.15	1,856.76	0.20	2,293.68	0.30
长期待摊费用	462.20	0.03	477.08	0.04	136.39	0.01	167.73	0.02

项目	2019.3.31		2018.12.31		2017.12.31		2016.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
递延所得税资产	6,246.58	0.43	5,906.68	0.47	4,369.07	0.47	4,069.49	0.53
其他非流动资产	42,953.79	2.98	39,244.68	3.15	45,438.81	4.85	34,788.57	4.53
非流动资产合计	1,000,369.76	69.48	686,362.04	55.16	578,329.61	61.74	450,778.71	58.72
资产总计	1,439,869.42	100.00	1,244,268.24	100.00	936,644.42	100.00	767,724.41	100.00

报告期内，由于公司业务规模的不断扩大，公司资产规模逐年增加。报告期各期末，公司资产总额分别为 767,724.41 万元、936,644.42 万元、1,244,268.24 万元和 1,439,869.42 万元，较期初增幅分别为 22.00%、32.84% 和 15.72%。从资产构成看，非流动资产占资产总额的比例较大，各期末占比分别为 58.72%、61.74%、55.16%和 69.48%，占比的提高主要是前次募投项目的实施、日常生产经营投入和 2019 年一季度将 Unisem 纳入合并报表范围导致公司固定资产增加所致。报告期内，公司资产结构特点与所处行业高固定资产投入的生产模式相匹配。

（二）负债状况分析

报告期各期末，公司负债规模及负债结构如下：

单位：万元，%

项目项目	2019.3.31		2018.12.31		2017.12.31		2016.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债：								
短期借款	225,198.54	33.17	210,088.54	34.62	53,213.68	15.79	1,500.00	0.69
应付票据及应付账款	162,724.94	23.97	154,400.04	25.45	168,247.55	49.91	115,098.10	53.00
预收款项	3,487.82	0.51	4,353.08	0.72	2,376.36	0.70	1,784.04	0.82
应付职工薪酬	4,644.61	0.68	10,765.59	1.77	13,046.04	3.87	9,708.27	4.47
应交税费	1,822.46	0.27	745.58	0.12	4,033.84	1.20	1,949.12	0.90
其他应付款	25,263.62	3.72	22,403.98	3.69	19,529.38	5.79	19,522.16	8.99
一年内到期的非流动负债	33,761.27	4.97	39,256.36	6.47	10,122.00	3.00	33,315.19	15.34
流动负债合计	456,903.27	67.30	442,013.17	72.85	270,568.85	80.27	182,876.89	84.20
非流动负债：								
长期借款	178,112.37	26.23	137,378.00	22.64	40,877.47	12.13	7,625.47	3.51
长期应付款	6,032.95	0.89	6,025.42	0.99	5,756.00	1.71	6,578.00	3.03
长期应付职工薪酬	6,010.75	0.89	-	-	-	-	-	-
预计负债	-	-	-	-	87.81	0.03	-	-
递延所得税负债	10,099.34	1.49	600.11	0.10	951.93	0.28	1,781.26	0.82
递延收益	21,778.38	3.21	20,758.68	3.42	18,848.30	5.59	18,323.08	8.44
非流动负债合计	222,033.78	32.70	164,762.21	27.15	66,521.51	19.73	34,307.81	15.80

项目项目	2019.3.31		2018.12.31		2017.12.31		2016.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
负债合计	678,937.05	100.00	606,775.38	100.00	337,090.36	100.00	217,184.70	100.00

注：占比为各负债占总负债的比。

报告期内，随着公司业务规模的不断扩大，公司负债规模逐年增加。报告期各期末，公司的负债总额分别为 217,184.70 万元、337,090.36 万元、606,775.38 万元和 678,937.05 万元，较上年末增幅分别为 55.21%、80.00% 和 11.89%；资产负债率分别为 28.29%、35.99%、48.77%和 47.15%，呈上升趋势；从负债结构看，报告期内公司负债主要为流动负债，流动负债在负债总额中占比分别为 84.20%、80.27%、72.85%和 67.30%。

（三）偿债能力分析

报告期内，公司的主要偿债指标情况如下表所示：

财务指标	2019.3.31	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
流动比率	0.96	1.26	1.32	1.73
速动比率	0.65	1.01	0.80	1.27
资产负债率（%）（母公司）	41.95	42.29	22.32	18.77
资产负债率（%）（合并）	47.15	48.77	35.99	28.29
财务指标	2019年1-3月	2018年度	2017年度	2016年度
利息保障倍数（倍）	1.46	7.23	33.99	25.53
经营活动现金流量净额（万元）	11,398.48	113,303.13	90,353.59	86,252.13

注 1：除资产负债率（母公司）外，上述财务指标均以合并报表口径进行计算；

注 2：上述财务指标的计算公式：

流动比率=流动资产÷流动负债

速动比率=（流动资产-存货）÷流动负债

资产负债率=（负债总额÷资产总额）×100%

利息保障倍数=（利润总额+利息支出）÷利息支出

报告期各期末，公司的流动比率分别为 1.73、1.32、1.26 和 0.96；速动比率分别为 1.27、0.80、1.01 和 0.65。2017 年末，公司流动比率和速动比率下降，主要是随着订单量的增加，购买原材料等生产性投入逐步增加，短期借款及应付账款增加所致；2018 年末，公司流动比率呈降低趋势，主要是日常生产经营需要，短期借款增加所致，速动比率略有提升，主要是存货减少所致；2019 年 3 月末，公司流动比率和速动比率呈降低趋势，主要是公司支付收购 Unisem 股权款，货币资金大幅减少所致。

报告期各期末，公司合并口径的资产负债率分别为 28.29%、35.99%、48.77%和 47.15%，随着公司业务规模的不断扩大，资产负债率有所提高。

报告期内，公司经营活动现金净流量指标较好，公司在偿还贷款本息方面未发生过借款到期未还的情况。2018 年和 2019 年 1-3 月利息保障倍数有所降低，主要是公司日常生产经营和收购 Unisem 需要，银行贷款增加，利息支出增加较多所致。

（四）营运能力分析

报告期内，公司反映资产管理能力的主要财务指标情况如下：

财务指标	2019.3.31	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
资产周转率（次）	0.13	0.65	0.82	0.74
流动资产周转率（次）	0.34	1.55	2.08	1.58
存货周转率（次）	1.19	4.65	5.04	6.49
应收账款周转率（次）	1.55	7.53	8.56	7.97

注 1：2019 年 1-3 月上述指标进行计算时未进行年化处理；

注 2：上述指标计算公式如下：

资产周转率=营业收入÷[(期初资产总额+期末资产总额)÷2]

流动资产周转率=营业收入÷[(期初流动资产+期末流动资产)÷2]

存货周转率=营业成本÷[(期初存货账面价值+期末存货账面价值)÷2]

应收账款周转率=营业收入÷[(期初应收账款账面价值+期末应收账款账面价值)÷2]

报告期内，公司的资产周转率分别为 0.74、0.82、0.65 和 0.13；流动资产周转率分别为 1.58、2.08、1.55 和 0.34。报告期内，随着公司 2015 年非公开发行股票募集资金到账及 2013 年可转债募投项目的实施，流动资产规模及总资产规模得以扩张，同时公司营业收入呈上升趋势，使得 2017 年资产周转率及流动资产周转率有所增加；2018 年由于公司日常生产经营和收购 Unisem 需要，借款较多导致货币资金增长较快，流动资产规模及总资产规模大幅增加，资产周转率和流动资产周转率有所降低；2019 年一季度年化后的资产周转率和流动资产周转率较 2018 年变动不大。

报告期内，公司存货周转率分别为 6.49、5.04、4.65 和 1.19，呈下降趋势，主要系随着前次募投项目的逐渐投产，公司各类产品的产销量不断提高，使得存货平均规模有所上升，导致存货周转率下降；2019 年一季度年化后的存货周转率较 2018 年变动不大。

报告期内，公司应收账款周转率分别为 7.97、8.56、7.53 和 1.55，2017 年随着订单数量的增加，公司营业收入大幅提高，应收账款周转率上升；2018 年和 2019 年一季度应收账款平均规模有所增加，应收账款周转率有所降低。

二、盈利能力分析

（一）营业收入分析

1、营业收入概况

最近三年，公司营业收入整体呈上升趋势，分别为 547,502.78 万元、700,987.61 万元、712,170.63 万元，营业收入增长的主要原因是：（1）随着公司前次募集资金投资项目产能的逐步释放，公司封装测试业务规模快速扩大；（2）公司产品在市场上知名度高、产品质量好、竞争实力强，具有一定的成本优势，客户订单增加；（3）公司生产技术水平、经营管理水平的提升和前次募投项目的实施有效地增加了公司的生产能力，营业收入增长。受半导体行业周期性波动、子公司产能释放不及预期等因素影响，2018 年公司营业收入较上年同期略有增长，2019 年一季度营业收入规模不及上年同期。

2、营业收入构成分析

最近三年，公司营业收入按产品类型构成如下：

单位：万元，%

项目	2018 年度		2017 年度		2016 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务收入	722,151.61	101.40	722,612.00	103.08	564,875.19	103.17
其中：引线框架类产品	475,064.41	66.71	441,942.06	63.05	343,072.10	62.66
基板类产品	115,537.52	16.22	150,986.29	21.54	85,661.01	15.65
晶圆级产品	76,419.99	10.73	95,022.94	13.56	103,216.07	18.85
LED 产品	26,222.17	3.68	12,159.66	1.73	14,492.06	2.65
其他主营业务	28,907.52	4.06	22,501.05	3.21	18,433.95	3.37
其他业务收入	21,768.92	3.06	13,191.93	1.88	8,115.29	1.48
小计	743,920.53	104.46	735,803.93	104.97	572,990.48	104.66
合并抵消	-31,749.91	-4.46	-34,816.32	-4.97	-25,487.70	-4.66
合计	712,170.63	100.00	700,987.61	100.00	547,502.78	100.00

注：其他主营业务主要为子公司华天机械、华天包装的主营业务；其他业务主要为边角废料销售和水、电、暖销售业务；占比为各项收入占合并抵消后合计收入的比例。

最近三年，公司主营业务收入占当期营业收入的比例较为稳定，从产品类型看，营业收入主要来源于引线框架类、基板类和晶圆级产品，三者合并抵消前收入合计占当期营业收入的比例为 97.16%、98.14%和 93.66%。其中，引线框架类产品作为公司的传统产品，最近三年营业收入分别较上年同期变动 28.82%和 7.49%，主要包括 DIP/SDIP 系列、SOT 系列、SOP 系列、SSOP/TSSOP/eTSSOP 系列、QFP/LQFP/TQFP 系列、QFN/DFN 系列等；基板类产品最近三年营业收入分别较上年同期变动 76.26%和-23.48%，主要包括 BGA/LGA 系列、FC 系列、MCM（MCP）系列和 SiP 系列等；晶圆级产品是较为高端的产品，主要包括 WLP 系列、TSV 系列、Bumping 系列和 MEMS 系列等。

3、地区构成分析

最近三年，公司营业收入按地区构成如下：

单位：万元，%

地区	2018 年度		2017 年度		2016 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
国内	301,251.31	42.30	265,260.62	37.84	210,116.80	38.38
国外	410,919.32	57.70	435,726.99	62.16	337,385.99	61.62
合计	712,170.63	100.00	700,987.61	100.00	547,502.78	100.00

公司进一步夯实在国内市场的销售规模，国内销售收入稳步提升。同时，公司加大海外市场拓展力度，进一步巩固和提升全球市场竞争力。

（二）营业成本分析

最近三年，公司营业成本按产品类型构成如下：

单位：万元，%

项目	2018 年度		2017 年度		2016 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务成本	613,414.67	102.93	603,765.39	104.90	471,026.42	104.97
其中：引线框架类产品	390,272.29	65.49	360,738.15	62.68	277,429.85	61.83
基板类产品	101,242.25	16.99	132,762.60	23.07	74,645.54	16.64
晶圆级产品	73,228.02	12.29	79,834.60	13.87	90,713.35	20.22
LED 产品	24,694.54	4.14	11,980.16	2.08	14,046.61	3.13
其他主营业务	23,977.58	4.02	18,449.88	3.21	14,191.07	3.16
其他业务成本	13,687.81	2.30	5,919.21	1.03	2,713.06	0.60

项目	2018 年度		2017 年度		2016 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
小计	627,102.48	105.23	609,684.60	105.93	473,739.48	105.58
合并抵消	-31,171.44	-5.23	-34,148.62	-5.93	-25,022.01	-5.58
合计	595,931.04	100.00	575,535.98	100.00	448,717.48	100.00

注：其他主营业务主要为子公司华天机械、华天包装的主营业务；其他业务主要为边角废料销售和水、电、暖销售业务；占比为各项成本占合并抵消后合计成本的比例。

报告期内，公司的营业成本变动趋势与营业收入变动趋势基本保持一致，各类产品的成本占总营业成本的比重较为稳定，公司营业成本随着订单量的增加，以及新增生产设备折旧增加而有所增加。

（三）营业毛利及毛利率

1、营业毛利

最近三年，公司营业毛利情况如下：

单位：万元，%

项目	2018 年度		2017 年度		2016 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务毛利	108,736.94	93.55	118,846.63	94.73	93,848.77	95.00
其中：引线框架类产品	84,792.13	72.95	81,203.92	64.73	65,642.26	66.45
基板类产品	14,295.27	12.30	18,223.69	14.53	11,015.47	11.15
晶圆级产品	3,191.97	2.75	15,188.35	12.11	12,502.72	12.66
LED 产品	1,527.64	1.31	179.50	0.14	445.45	0.45
其他主营业务毛利	4,929.94	4.24	4,051.17	3.23	4,242.87	4.30
其他业务毛利	8,081.11	6.95	7,273.83	5.80	5,402.23	5.47
小计	116,818.06	100.50	126,120.46	100.53	99,251.00	100.47
合并抵消	-578.46	-0.50	-667.70	-0.53	-465.69	-0.47
合计	116,239.59	100.00	125,452.72	100.00	98,785.31	100.00

注：其他主营业务为子公司华天机械、华天包装的主营业务；其他业务主要为边角废料销售和水、电、暖销售业务；占比为各业务毛利占营业毛利合并抵消后合计的比例。

最近三年，公司主营业务毛利是营业毛利的主要来源，主营业务毛利占当期营业毛利的比例分别为 95.00%、94.73%和 93.55%；主营业务毛利分别较同期变动为 26.64%和-8.51%；从产品类型看，营业毛利主要来源于引线框架类产品、基板类产品和晶圆级产品，三者合计占当期营业毛利的比例为 90.26%、91.37%和 88.00%，主要产品的盈利能力直接影响公司的经营成果。

2、营业毛利率

最近三年，公司主要产品毛利率情况如下：

单位：%

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
引线框架类产品	17.85	18.37	19.13
基板类产品	12.37	12.07	12.86
晶圆级产品	4.18	15.98	12.11
LED 产品	5.83	1.48	3.07
其他主营业务	17.05	18.00	23.02
其他业务毛利率	37.12	55.13	66.57
营业毛利率	16.32	17.90	18.04

注：其他主营业务为子公司华天机械、华天包装的主营业务；其他业务主要为边角废料销售和水、电、暖销售业务。

最近三年，公司营业毛利率有所降低，主要原因是：（1）近年来，国际集成电路封测厂商纷纷将其业务向中国转移，加上国内集成电路封测企业不断扩大其生产规模和能力，使国内行业竞争加剧，公司产品平均单价有所降低；（2）公司营业成本增幅较大：①因实施 2013 年可转债和 2015 年非公开发行募投项目，厂房、机器设备等非流动资产逐年增加且金额较大，计提的折旧摊销金额不断上升，对营业成本的增加影响较大；②报告期内，随着公司生产规模的扩张，员工数量不断增加，近年来，劳动力市场的流动性增强，为吸引更多技术骨干，提升员工的忠诚度，公司不断提高员工的薪酬水平，导致营业成本增加；③受部分原材料价格波动等因素的影响，原材料成本有所波动；（3）2018 年下半年以来，受宏观经济增速放缓、下游应用领域增长乏力等因素影响，我国集成电路产业规模增速放缓，行业景气度下行对公司业绩造成不利影响。

（四）期间费用

报告期内，公司期间费用构成及变动情况如下：

单位：万元，%

项目	2019 年 1-3 月		2018 年度		2017 年度		2016 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
销售费用	1,920.97	1.12	7,989.76	1.12	7,389.15	1.05	6,142.82	1.12
管理费用	7,240.62	4.23	26,243.21	3.68	23,070.08	3.29	21,191.46	3.87
研发费用	6,323.48	3.70	38,351.20	5.39	35,333.76	5.04	28,993.18	5.30

财务费用	4,161.74	2.43	1,410.94	0.20	627.53	0.09	-1,172.65	-0.21
期间费用合计	19,646.81	11.48	73,995.11	10.39	66,420.52	9.48	55,154.81	10.07

注：上表中“占比”计算的分母为营业收入。

三、现金流量分析

报告期内，公司现金流量情况如下表所示：

单位：万元

项目	2019 年 1-3 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
一、经营活动产生的现金流量净额	11,398.48	113,303.13	90,353.59	86,252.13
二、投资活动产生的现金流量净额	-213,025.34	-144,952.70	-169,385.71	-143,989.35
三、筹资活动产生的现金流量净额	34,480.39	268,752.00	56,191.81	-41,956.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,950.97	-618.91	-540.58	195.92
五、现金及现金等价物净增加额	-170,097.44	236,483.51	-23,380.89	-99,498.12
加：期初现金及现金等价物余额	305,834.72	69,351.21	92,732.10	192,230.21
六、期末现金及现金等价物余额	135,737.28	305,834.72	69,351.21	92,732.10

（一）经营活动现金流量分析

报告期内，公司经营活动现金流入主要为“销售商品、提供劳务收到的现金”，经营活动现金流出主要为“购买商品、接受劳务支付的现金”及“支付给职工以及为职工支付的现金”。公司在报告期内经营活动现金流入持续增加，主要是随着公司生产经营规模的扩大，产品销售收入增加，同时公司对客户的资信情况、回款情况进行及时的管理和维护，现金回收能力相对较强。

（二）投资活动现金流量分析

报告期内，公司投资活动现金流量净额分别为-143,989.35 万元、-169,385.71 万元、-144,952.70 万元和-213,025.34 万元。投资活动的现金流出主要为“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”及“取得子公司及其他营业单位支付的现金净额”。报告期内，公司投资活动现金净流量均为负数，主要系公司固定资产投资较多及收购 Unisem 股权支付的投资款较大所致。

（三）筹资活动现金流量分析

报告期内，公司筹资活动现金流量净额分别为-41,956.82 万元、56,191.81 万元、268,752.00 万元和 34,480.39 万元。筹资活动的现金流入主要为“取得借款收到的现金”，筹资活动的现金流出主要为“偿还债务支付的现金”。公司筹资活动主要是与银行之间的借款。2018 年度公司筹资活动现金流量为净流入且金额较大，主要系公司因日常生产经营和收购 Unisem 股权取得的银行借款较多所致。

第六节 本次募集资金运用

一、本次募集资金的使用计划

(一) 预计募集资金数额

根据公司第五届董事会第十九次会议决议，并经 2018 年第三次临时股东大会批准，公司本次配股拟募集资金总额不超过人民币 170,000.00 万元。

(二) 本次募集资金投资项目概况

1、项目概况

本次募集资金投资项目经公司股东大会审议确定，由董事会负责实施。本次配股预计募集资金总额不超过人民币 170,000.00 万元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金与偿还公司有息债务，其中：不超过 80,000 万元用于补充流动资金，不超过 90,000 万元用于偿还公司有息债务。

2、实际募集资金量与投资项目需求出现差异时的安排

若本次配股发行实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司自筹解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会及其授权人士可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次募集资金到位前，公司将根据有息债务的实际到期日通过自筹资金先行偿还，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。

(三) 环评、备案等政府审批情况

本次募集资金用于偿还有息债务和补充流动资金，未进行固定资产等项目投资，资金用途符合国家产业政策，无需办理环评、备案等手续。

(四) 本次融资的背景

1、国家产业政策支持

集成电路产业作为我国国民经济和社会发展的战略性、基础性和先导性产业，是培育发展战略性新兴产业、推动信息化和工业化深度融合的核心与基础，

集成电路产业以其极强的创新力和融合力，已经渗透到人民生活、生产以及国防安全的方方面面，在推动经济发展、社会进步、提高人民生活水平以及保障国家安全等方面发挥着重要的作用。为了促进我国集成电路产业的持续发展，突破和掌握核心技术，增强信息产业创新能力和竞争力，推进国民经济和社会信息化，国家推出一系列鼓励性政策，为集成电路产业的发展提供了良好的产业政策环境。

2015 年 5 月，发改委发布《中国制造 2025》，就集成电路封装测试领域，明确提出要掌握高密度封装及三维微组装技术，提升封装产业和测试的自主发展能力。2016 年 10 月，工信部正式发布《产业技术创新能力发展规划（2016-2020 年）》，该规划明确要求着力提升集成电路设计水平，发展高端芯片，不断丰富知识产权 IP 核和设计工具，推动先进制造和特色制造工艺发展，提升封装测试产业的发展水平，形成关键制造装备和关键材料供货能力，加紧布局超越摩尔相关领域。2016 年 12 月，在国务院先后印发的《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《“十三五”国家信息化规划》中连续两次提到推动集成电路封装测试、关键装备和材料等产业快速发展，加快 16/14 纳米工艺产业化和存储器生产线建设，提升封装测试业技术水平和产业集中度，加紧布局后摩尔定律时代芯片相关领域，大力发展芯片级封装、圆片级封装、硅通孔和三维封装等研发和产业化进程等。2017 年，发改委会同科技部、工信部、财政部等有关部门根据战略性新兴产业发展新变化，修订、完善并形成《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 版）》，该目录将集成电路芯片封装作为重点产业之一，将采用 SiP、MCP、MCM、CSP、WLP、BGA、FlipChip、TSV 等技术的集成电路封装作为重点产品发展方向。

国家产业政策的大力支持、相关配套政策的颁布实施，都为国内集成电路企业带来新的发展机遇，为公司创造了良好的产业发展环境。

2、国家集成电路市场需求巨大

集成电路广泛应用于计算机、消费电子、网络通信等终端领域。我国集成电路产业通过多年的快速发展，产业整体实力显著提升，对电子信息产业以及经济社会发展的支撑带动作用日益显现。根据半导体协会统计，国内集成电路产量从

2009 年的 414 亿块提高到 2017 年的 1,564.9 亿块，年复合增长率为 18.08%；销售额从 2009 年的 1,109.13 亿元提高到 2017 年的 5,411.30 亿元，年复合增长率为 21.91%。我国已成为全球集成电路产业增长最快的地区之一。集成电路产业的持续增长和巨大的市场需求带动了集成电路封装测试产业的快速发展。

由于我国集成电路产业的发展速度跟不上广阔的市场需求，集成电路进口量一直保持快速增长。根据中华人民共和国海关总署统计，2018 年中国集成电路进口量及出口量持续增长，进口量达到 4,176 亿块，同比增长 10.8%；出口量达到 2,171 亿块，同比增长 6.2%。集成电路已超过原油，成为我国第一大进口商品，巨大的供需缺口使我国集成电路企业面临通过替代进口实现快速增长的良好机遇。

（五）募集资金使用的必要性和可行性

1、补充流动资金必要性和可行性

（1）集成电路市场前景广阔带动了对集成电路封装测试产品的需求

近年来，受益于计算机、通信和消费电子以及节能环保、物联网、新能源汽车等新兴领域的发展，我国集成电路产业增长强劲。随着市场需求的快速增长、集成电路应用领域的不断拓展、技术水平的不断提高，以及国家、地方相关产业政策与资本的有力支持，我国集成电路产业发展速度仍领先于全球半导体产业，继续保持增长势头。集成电路封装测试业也成为我国半导体产业的发展主体，在市场、技术、产业链等方面全面向国际先进水平靠拢。

集成电路产业的持续增长和巨大的市场需求带动了集成电路封装测试产业的快速发展。2018 年，国内封装测试业仍保持增长，销售收入达到 2,193.9 亿元，同比增长 16.1%。

（2）公司业务扩张加大对流动资金需求

公司所处的集成电路封装测试行业属于资金密集型行业，公司经营规模的逐步扩张加大了对流动资金的需求。2009 年-2018 年，公司经营规模持续增长，资产总额由 13.12 亿元增加至 124.43 亿元，年复合增长率 28.40%；产量由 32.67 亿块增加至 267.24 亿块，年复合增长率 26.30%；营业收入由 7.77 亿元

增加到 71.22 亿元，年复合增长率 27.91%。总资产及营业收入的快速增长导致公司应收账款、存货等经营性资产大幅增加。截至 2019 年 3 月 31 日，公司应收账款和存货分别为 11.90 亿元和 14.07 亿元，对流动资金形成较大的占用。此外，随着公司经营规模的扩张，公司生产经营所需的原材料采购成本、人力成本、动力运行成本、研发等支出也相应增长，进一步增加了公司对流动资金的需求。因此，公司必须及时补充经营活动所需的流动资金，以满足不断扩张的业务需要。

（3）有助于满足公司未来发展的需要，进一步夯实公司发展的资本实力

集成电路封装测试业是规模效益较为明显的行业，从世界集成电路产业发展路径和公司长远发展以及国际化战略实施考虑，只有不断提高集成电路先进封装测试的工艺技术水平、扩大产能规模和产品应用领域，才能提高公司在国内外集成电路先进封装测试市场的占有率，保持市场领先地位。

根据公司的经营战略和未来发展规划，为完善产业布局，加快公司业务发展，不断提升公司的盈利能力，必须要有充足的资金作为保障。经测算，公司未来三年流动资金需求缺口较大，本次配股募集资金中用于补充流动资金的金额不超过流动资金需求额。另外，报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额分别为 -14.40 亿元、-16.94 亿元、-14.50 亿元和 -21.30 亿元，显示公司近几年处于快速发展的阶段，对资金的需要量较大。

随着市场竞争日趋激烈，客户对公司的产品升级、工艺提升等不断提出更高的要求，需要公司对研发进行持续的资金投入。报告期内，公司研发投入逐年上升，分别为 2.90 亿元、3.53 亿元、3.84 亿元和 0.63 亿元。持续增长的研发投入及研发成果的产业化使公司在集成电路封测领域始终保持着技术领先优势，预计公司未来几年对研发的投入将继续提高。

2、偿还有息债务的必要性和可行性

（1）偿还有息债务以优化资本结构，增强公司抗风险能力

公司业务一直处于快速发展状态，自 2015 年非公开发行完成后，公司后续的项目建设主要通过银行贷款方式筹集资金。近年来，公司的资产负债率呈

上升趋势，流动比率、速动比率有所下降，且资产总额中非流动资产的占比、有息债务占流动负债的比例均呈上升趋势，公司财务风险增大。报告期各期末，公司合并报表资产负债率分别为 28.29%、35.99%、48.77%和 47.15%，流动比率分别为 1.73、1.32、1.26 和 0.96，速动比率分别为 1.27、0.80、1.01 和 0.65，非流动资产占资产总额的比例分别为 58.72%、61.74%、55.16%和 69.48%，流动负债占负债总额的比例分别为 84.20%、80.27%、72.85%和 67.30%。

随着业务规模的不断扩张，公司资产负债率持续增长、流动比率下降，有息债务规模不断扩大，偿债风险升高，本次配股部分募集资金用于偿还公司有息债务，符合国家“降杠杆”政策，有利于缓解公司的资金需求压力，控制总体负债规模，逐步降低资产负债率，通过股权融资增加权益资本，有效改善资本结构，增强公司防范财务风险的能力，为公司未来持续稳定发展奠定坚实的基础。

（2）偿还有息债务可以减轻公司财务负担，提高公司盈利水平

虽然债务融资方式对公司快速扩大经营规模提供了资金支持和保障，但同时也为公司带来了一定的利息支出。大额的财务费用支出，很大程度上影响了公司的盈利水平，也对公司造成一定的经营业绩压力。本次募集资金拟不超过 90,000 万元用于偿还有息债务，每年可以节约一定的利息支出，有效降低财务费用，对提高公司盈利水平起到积极的作用。

二、本次募集资金运用对财务状况及经营成果的影响

1、对经营成果的影响

本次发行完成后，公司的资金实力将得到提升，有助于进一步缓解公司流动资金压力，为公司各项经营活动的开展提供资金支持，有利于公司业务经营规模的持续稳定扩大，并将带动公司营业收入和净利润的增长，提升公司整体竞争力和可持续发展能力。

2、对财务状况的影响

本次发行完成后，公司资本实力将得以显著增强，净资产和总资产相应增加，资本结构将进一步优化。公司营运资金得到有效补充，偿债压力得到缓解，有助于节省公司财务费用，降低公司财务风险，提高偿债能力，公司的经营规模和盈利能力将进一步提升，有利于实现全体股东利益的最大化。

第七节 备查文件

- 一、发行人最近三年一期的财务报告、审计报告
- 二、保荐人出具的发行保荐书和保荐工作报告
- 三、法律意见书和律师工作报告
- 四、注册会计师关于前次募集资金使用情况的专项报告
- 五、其他与本次发行有关的重要文件

投资者可在发行期间每周一至周五上午九点至十一点，下午三点至五点，于下列地点查阅上述文件：

1、发行人：天水华天科技股份有限公司

地址：甘肃省天水市秦州区赤峪路 88 号

联系人：常文璞

联系电话：0938-8631816/8631990

传真：0938-8632260

2、保荐人、主承销商：瑞信方正证券有限责任公司

办公地址：北京市西城区金融大街甲九号金融街中心南楼 15 层

联系人：陈万里、盖建飞

联系电话：010-66538666

传真：010-66538566

投资者亦可在本公司的指定信息披露网站查阅配股说明书全文。

(本页无正文,为《天水华天科技股份有限公司配股说明书摘要》之盖章页)

天水华天科技股份有限公司



2019 年 6 月 28 日